

<近日発刊レポートのご案内>

先端ICパッケージとRDL材の動向 2025

<調査対象>

- * 先端ICパッケージ: 2.xDパッケージ、3Dパッケージ、FO-PKG等
- * RDL材: 感光性絶縁材料

<調査のポイント>

- * AI向けxPU、AI ASICの市場拡大とPKGの2.xD化、3.5D化の動向
- * 2.xDパッケージの大型化、高密度実装化による組立技術と関連材料の動向
- * 樹脂系インターポーザとFan-out PKG向けRDL材の市場と技術の動向

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">◆ 発刊予定日: 2024年12月26日◆ サイズ/頁数: A4判、約150ページ◆ 価格(税込): 550,000円(コーポレート契約)
770,000円(グローバル契約) |
|---|

株式会社 ジャパンマーケティングサーベイ

TEL: 03-5829-3891 FAX: 0120-052-807

URL) <http://www.jms21.co.jp>

＜調査内容・項目＞

第1章 AI向け主要ICの動向

1. シリコンプロセス微細化ロードマップ
2. サーバ/HPC向けIC
3. 主要xPU企業の製品動向
4. その他のHPC/ハイエンドサーバ向けIC

第2章 先端ICパッケージの動向

A.技術動向

1. チップレット/IC集積化技術の概要
2. 先端パッケージの概要
3. 2.xDパッケージ
4. 3Dパッケージ
5. 微細ピッチ接合技術

B.市場動向

1. 主要組立企業の参入状況
2. 全体市場規模動向（2.5D + FO-PKG）
3. 2.xD系PKGの市場規模推移予測（～2034年）
4. 3D PKGの市場規模推移予測（～2034年）
5. Fan-out PKGの市場規模推移予測（～2034年）

第3章 RDL絶縁材料の動向

1. 絶縁樹脂コート材の概要
2. 絶縁樹脂コート材の要求特性
3. RDL・構造用途のアプリケーション
4. 絶縁樹脂コート材メーカーの参入状況
5. 絶縁樹脂コート材の品番別材料特性
6. 絶縁樹脂コート材の市場と企業の動向
 - 1) 主要企業別動向（2024年）
 - 2) 市場規模推移予測（～2034年）

申込要項

▼ 支払方法

レポート発刊後、請求書をレポートと同封でお送りいたします。お支払いは原則として、請求日の翌月末日までに銀行振り込みにてお願いいたします。

▼ 納品形態

製本 1部 及び CD (PDFファイル) 1枚

▼ 調査レポートのお取り扱い

調査レポートのデータについては、ご契約内容により、ご契約頂いた同一法人内、または、出資比率51%以上の子会社までにその利用範囲を限定させていただきます。また、第三者への譲渡、複写を禁止いたします。

調査レポート申込書

_____年 月 日

(株)ジャパンマーケティングサーベイ 行 (FAX:03-5829-3892)

レポート名: “先端ICパッケージとRDL材の動向 2025”

上記の調査資料の取扱いについて同意の上、該当するお申込み項目に☑をご記入下さい

コーポレート契約: 550,000円(税込)

グローバル契約: 770,000円(税込)

※ ご利用はコーポレート契約では同一法人内に限定され、グローバル契約は出資比率51%以上の子会社までとなります

企業名: _____

申込希望者: _____ 同役職: _____

窓口担当者: _____

所属: _____

E-mail address: _____

TEL: _____

住所(送付先): (〒 _____ ー _____)

連絡事項